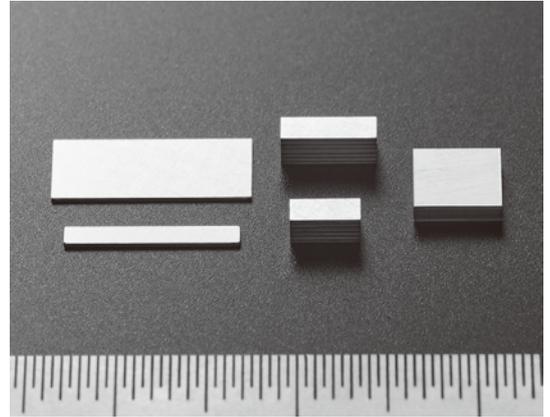


金錫はんだ膜付きサブマウント

お客様での実装を容易にする金錫はんだ膜を施したサブマウントです。Cu/Moの積層基板はCuW、CuMoよりも高い熱伝導率特性を有し、Graphite+Cuはさらに超高熱伝導特性を有します。

●特性

- 信頼性の高い強固な接合強度を実現
- 金と錫の組成比や厚みを調整可能
- 下地膜(メタライズ膜)の構成を調整可能
- パターン成膜を施すことが可能
- ご希望特性に応じた材質を選択可能



●用途例

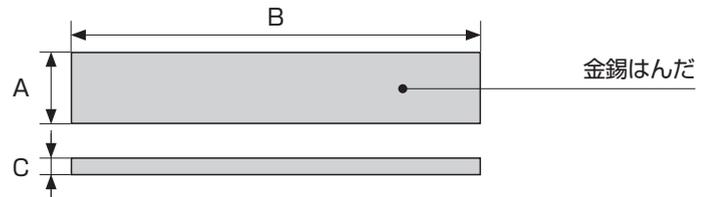
- 高出力LD用ヒートシンク

●材質

- CuW、CuMo、Cu/Mo積層基板、Graphite+Cu、Graphite、Diamond、Cu-AlN-Cu 他

●仕様例

- 寸法(mm) : A=1.50、B=10.00、C=0.25
- 組成比 Au : Sn=78、22 (wt%)
- 膜厚 5 μ m



●材質特性

基材	含有割合	熱伝導率 (W/m \cdot K)		熱膨張係数 $\times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$
		膜厚方向	面方向	
CuW	W 90wt%	174	174	6.4
	W 80wt%	206	206	8.3
CuMo	W 85wt%	130	130	6.6
	W 65wt%	207	207	8.0
Cu/Mo 積層基板	Mo 40wt%*1	230	220	6.6
	Mo 20wt%	291	334	7.4
	Mo 10wt%	335	369	11.8
	Mo 5wt%	362	381	14.8
Graphite + Cu*2	—	50	800	4.0 ~ 8.0

*1 : Cu/Mo積層基板 Mo 40wt%は、同CTEのCuW、CuMoと比較し、より高い熱伝導率

*2 : Graphite+Cuは、CTEをLDチップに合わせながら800W/m \cdot Kという超高熱伝導特性